



# 2020年12月期第3季度決算説明資料

株式会社RS Technologies

2020年11月12日



東証1部  
3445

# 目录

## 公司概况 P. 3

公司概况  
历史沿革  
山东有研 新工厂竣工  
中国子公司上市准备开始  
现在的RS Technologies  
硅片再生事业各地区供货量构成比

## 2020年12月期第3季度 决算概况 P. 10

决算概况（累计）  
各事业及公司的动向（累计）  
决算概况（7-9月）  
各事业及各公司的动向（7-9月）  
各事业动向季度业绩图  
各公司动向季度业绩图  
资产负债表

## 中期经营计划(20年~23年)展望 P. 18

中期经营计划(4年)概况  
设备投资计划:硅片再生事业  
设备投资计划:Prime Wafer事业  
中国投资计划变动  
中国投资计划(时间表)  
中国投资计划(目前进展情况)  
12英寸硅片事业方案  
硅片再生事业的新需求  
再生硅片的需求前景  
RS Technologies追求的世界

## Appendix P. 28

董事长方永义的优势  
硅片再生事业(1)(2)  
进军Prime Wafer行业  
关于我们在中国的合资伙伴  
与山东省德州市合作:背景、经过及现状  
对中国事业的出资方案  
业绩变化  
主要财务报表  
各事业业绩变化

# 1. 公司概况

---

# 公司概况

- 硅片再生市场份额占30%的全球领先企业\* 1。
- 与中国中央政府直属企业合资，全面进军优质晶圆业务。
- 通过M&A将业务扩展到可以实现协同效果的相关业务领域。

公司名称	株式会社RS Technologies
成立日期	2010年12月10日
经营理念	“爱护地球环境，赢得世界各地客户的信赖，坚持不懈地创造挑战。”
业务内容	电子材料、电子器械元件、通信器械元件材料的制造、加工、再生、销售，太阳能发电业务。旧半导体设备的收购和销售业务。半导体材料和元件的销售。半导体硅片制造的技术咨询服务。
总部地址	东京都品川区大井1-47-1 NT 大厦12楼
三本木工厂	宫城县大崎市三本木音无字山崎26-2
资本金	5,438百万日元（截至2020年9月底）
代表取締役	方永义
主要子公司	艾尔斯半导体股份有限公司（台湾）资本金 NT \$300 million 出资比例100%
	北京有研艾斯半导体科技有限公司（北京）注册资本US \$138 million 出资比例45% ※2
	有研半导体材料有限公司（北京）注册资本 8亿人民币 出资比例45% ※2
	株式会社Union Electronics 资本金 27百万日元 出资比例100%
	山东有研半导体材料有限公司（山东省德州市）注册资本金15亿人民币 出资比例36% ※2
	株式会社DG Technologies 资本金 100百万日元 出资比例100%

\* 1 由本公司根据SEMI数据估算。

\* 2 在中国业务中，属于合并对象的出资计划包括，将北京有研艾斯半导体科技有限公司作为总公司，将有研半导体材料有限公司作为子公司，山东有研半导体材料有限公司作为孙子公司，出资部分重复。有关详细信息，请参阅P35“中国企业投资计划”。

# 沿革

■ 硅片再生业务的全球领导者。将中国一家主要Prime Wafer制造商作为合资子公司，成为综合硅片制造商。

■ 2020年10月，山东省德州市的山东GRITEK新工厂竣工。

2010年12月	以硅片再生业务为主要业务，成立株式会社RS Technologies
2011年1月	在三本木工厂开工
2011年11月	三本木工厂通过UKAS“ISO9001:2008”（质量管理体系）认证审核
2013年10月	在三本木工厂开始太阳能业务
2014年2月	在台湾成立子公司——艾尔斯半导体股份有限公司（现为合并子公司）
2015年3月	在东京证券交易所创业板上市
2015年6月	引进最先进设备（可再生18英寸晶圆）的三本木工厂和第8工厂竣工
2015年12月	艾尔斯半导体股份有限公司（现为合并子公司）的台南工厂竣工
2016年9月	变为东京证券交易所主板上市企业
2017年12月	与北京有研科技集团有限公司（GRINM）和福建仓元投资有限公司签订三家公司的合资合同
2018年1月	成立北京有研RS半导体科技有限公司（BGRS），将中国Prime Wafer制造商有研半导体材料有限公司（GRITEK）变为合并子公司
2018年5月	取得100%的株式会社Union Electronics的股份
2019年12月	与GRINM、德州汇达半导体股权投资基金合作企业及山东省德州市政府之间签订四方合并合同
2020年2月	成立上海悠年半导体有限公司（上海悠年）
2020年3月	成立山东有研RS半导体材料有限公司（SGRS）及有研艾唯特（北京）科技有限公司（北京IVT）
2020年10月	中国的Prime Wafer生产据点山东GRITEK的新工厂竣工

# 山东有研 新工厂竣工

- 2020年10月、在山东省德州市山东GRITeK新工厂竣工。
- 作为在中国的Prime Wafer制造据点开始运作。



# 中国子公司（GRITEK）开始准备上市

- 2020年9月、中国子公司（GRITEK）开始准备上市。
- 通过上市确保事业基础，以确保更大的发展能力并提高集团的企业价值。

## 上市的目的

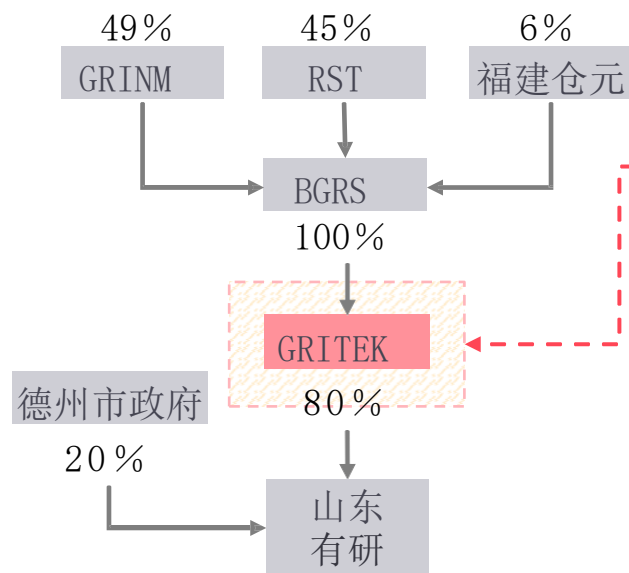
### 确保中国事业基础

- 融资方式的多样化
- 品牌实力的提高
- 获得优秀的人才

### 发展能力的确保

- 获得增长资金
- 加强销售力量
- 促进研究开发和生产率的提高

集团企业价值的提高



## 上市主体：GRITEK

- 1999年成立、Prime Wafer的制造与销售
- 2018年成为本集团的合并子公司
- 2020年通过迁移工厂，将山东GRITEK作为Prime Wafer生产据点

## 预计上市市场：科创板市场（star market）

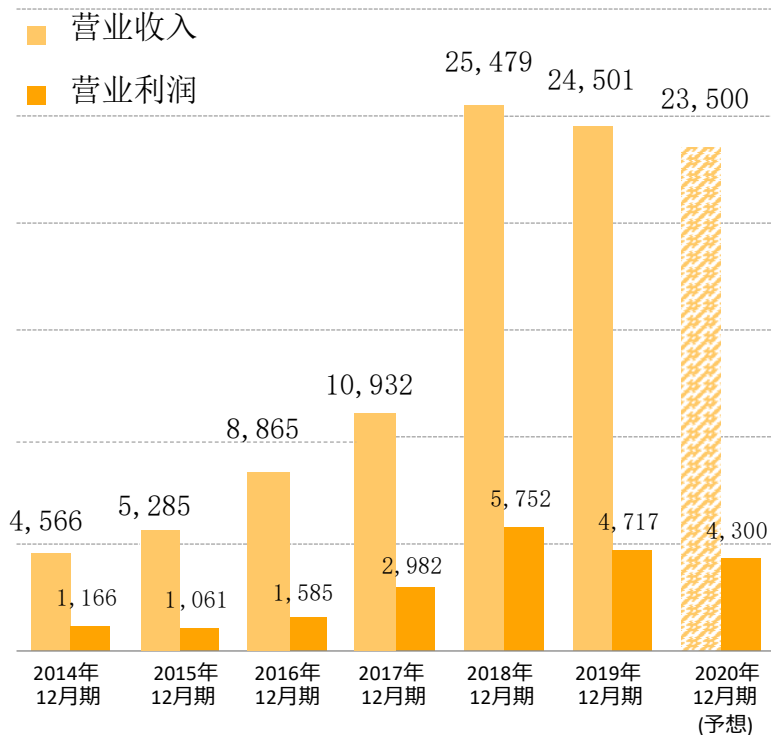
- 被称为中国版纳斯达克的上海证券交易所是面向新兴创业公司的股票市场
- 在中国政府领导下开设，于2019年7月22日开始进行交易
- 与其他市场相比，放宽了盈利能力等上市标准，简化了审查程序
- 交易以新兴的高科技企业为中心
- 最初有2股上市，一年内扩展到30多家公司

# 现在的RS Technologies

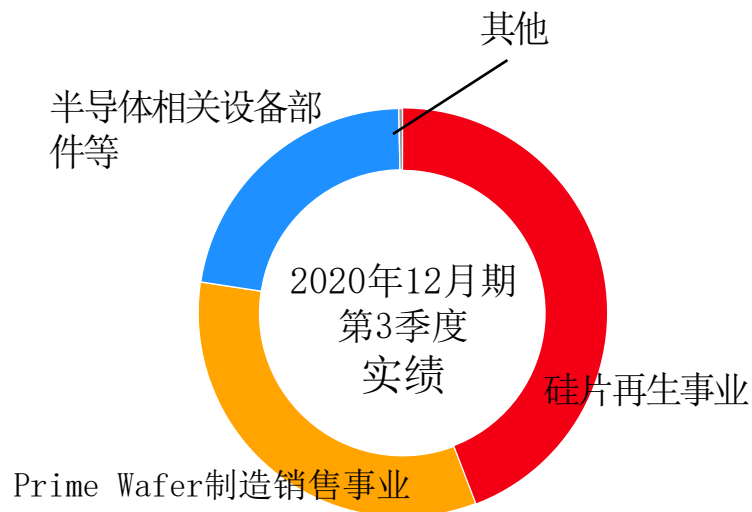
- 硅片再生事业 + Prime Wafer事业的综合硅片制造商
- 在半导体相关设备部件等事业及太阳能事业领域扩展业务
- 硅片再生事业在全球占领先地位，Prime Wafer事业主要面向中国国内开展。

## 合并营业收入及利润

(百万日元)



## 各事业领域营业收入

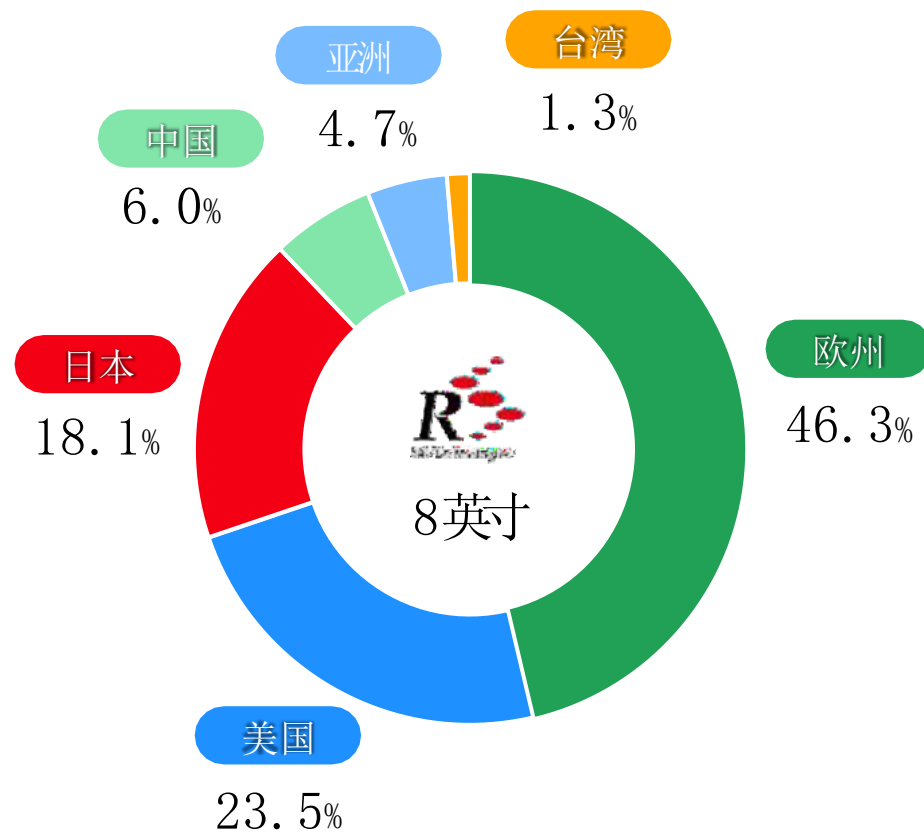
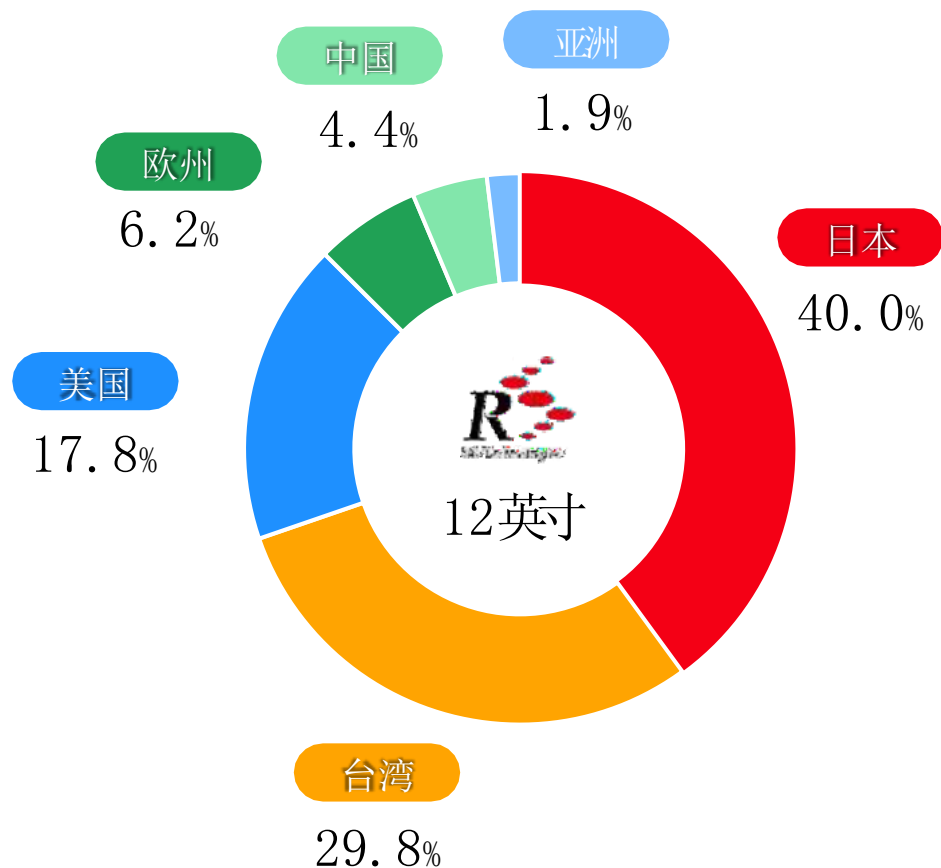




# 硅片再生事业各地区出货量比

■以日本、台湾、欧美为中心的世界主要半导体制造商为顾客。

■2020年10月山东有研的新工厂竣工，以应对今后不断增长的需求。



注：由RST调查，以片数为基准（2018年度）

## 2. 2020年12月期第3季度 決算概況

---

# 2020年12月期第3四半期 決算概況

- 虽然Prime Wafer事业收入有所减少，但由于硅片再生事业以及半导体相关设备部件等事业的好转，与前年度相比营业收入增加。

(百万日元)	2019年12月期 第3季度 累计	2020年12月期 第3季度 累计	前年同期比	差额
营业收入	18,619	18,999	+2.0%	+380
营业利润	3,745	3,901	+4.2%	+156
营业利润率	20.1%	20.5%		+0.4pt
经常利润	4,310	4,182	△3.0%	△128
经常利润率	23.1%	22.0%		△1.1pt
归属于母公司股东的 净利润	2,506	2,330	△7.0%	△176
每股当期净利润	195.74円	180.96円	△14.78円	

- 硅片再生事业，在客户持续旺盛的需求背景下，生产能力的提高促进了营业收入和利润的同比增长。
- Prime Wafer事业由于全球经济放缓和工厂搬迁，营业收入和利润同比下降。。
- 半导体相关设备部件事业由于强化销售能力等措施来增加营业收入，因此营业收入和利润同比增长。

各事业 (百万日元)	硅片再生事业		Prime Wafer事业		半导体相关设备部件等事业		其他、调整金额		合并总计	
		前期比		前期比		前期比		前期比		前期比
营业收入	8,417	+7.0%	7,001	△11.8%	4,254	+39.4%	△673	—	18,999	+2.0%
营业利润	3,072	+6.0%	1,373	△9.8%	113	+8.7%	△657	—	3,901	+4.2%
营业利润率	36.5	△0.3Pt	19.6	+0.4Pt	2.7	△0.8Pt	—	—	20.5	+0.4Pt

各公司 (百万日元)	RS		台湾子公司		中国子公司		其他子公司		合并总计	
		前期比		前期比		前期比	合并消除	前期比		前期比
营业收入	8,115	+14.0%	3,505	+42.7%	6,983	△12.1%	396	—	18,999	+2.0%
营业利润	1,484	+4.3%	1,057	+34.0%	1,445	△8.0%	△85	—	3,901	+4.2%
营业利润率	18.3	△1.7Pt	30.2	△2.0Pt	20.7	△1.4Pt	—	—	20.5	+0.4Pt

# 2020年12月期第3季度（7-9月）决算概況

- 营业收入同比增长归因于硅片再生事业产能的增长和半导体相关设备部件事业营业收入额的增长。
- 营业利润同比增长主要是由于Prime Wafer事业的成本改善。

(百万日元)	2019年12月期 第3季度	2020年12月期 第3季度	前年同期比	差额
营业收入	6,104	6,346	+4.0%	+243
营业利润	990	1,320	+33.3%	+330
营业利润率	16.2%	20.8%		+4.6pt
经常利润	1,389	1,284	△7.6%	△105
经常利润率	22.8%	20.2%		△2.5pt
归属于母公司股东的 净利润	783	643	△17.9%	△140
每股当期净利润	61.20円	49.69円	△18.8%	△11.51円

# 2020年12月期第3季度（7-9月）各事业及各公司动向

- 硅片再生事业由于设备投资生产能力的增加，营业收入和利润同比增长。
- Prime Wafer由于客户需求的增加，比前年同期增加。营业利润在营业收入增长的基础上，由于产品收率的提高以及原材料成本的降低而改善了成本，与前年同期相比利润增长。
- 半导体相关设备部件等事业，由于强化营业能力等措施营业收入比前年同期增加。营业利润与前年同期相比减少。

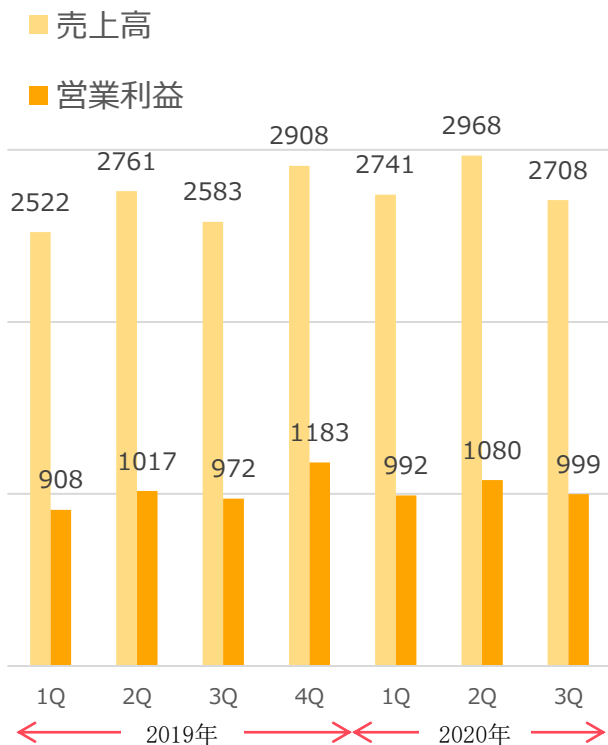
各事业 (百万日元)	硅片再生事业		Prime Wafer事业		半导体相关设备部件等事业		其他、调整金额		合并总计	
		前期比		前期比		前期比		前期比		前期比
营业收入	2,708	+4.8%	2,226	+1.0%	1,672	+20.4%	△260	—	6,346	+4.0%
营业利润	999	+2.8%	500	+97.6%	18	△28.0%	△197	—	1,320	+33.3%
营业利润率	36.9	△0.7pt	22.5	+11.0pt	1.1	△0.7pt	—	—	20.8	+4.6pt

各公司 (百万日元)	RS		台湾子公司		中国子公司		其他子公司		合并总计	
		前期比		前期比		前期比	合并消除	前期比		前期比
营业收入	2,893	+8.8%	1,129	+44.2%	2,221	+0.7%	103	—	6,346	+4.0%
营业利润	502	△1.8%	290	+26.6%	524	+129.8%	4	—	1,320	+33.3%
营业利润率	17.4	△1.9pt	25.7	△3.6pt	23.6	+13.3pt	—	—	20.8	+4.6pt

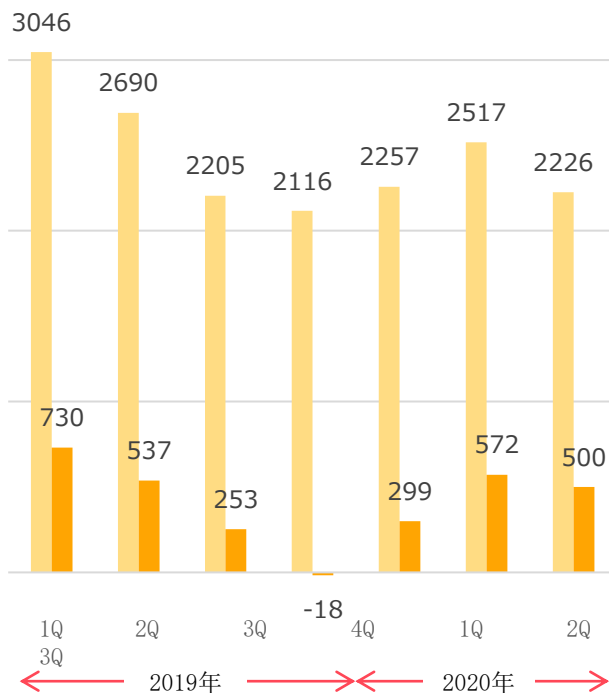
# 2020年12月期第3季度 各事业季度业绩图

- 硅片再生事业因季节因素与上一季度相比营业收入与利润减少。预计客户需求将持续旺盛，满负荷生产将持续。
- Prime Wafer由于工厂搬迁到德州市新工厂的影响，与上季度相比营业收入与利润减少。
- 半导体相关装置部件等事业，由于强化营业能力等措施的销售增加，与上季度相比营业收入与利润增加。

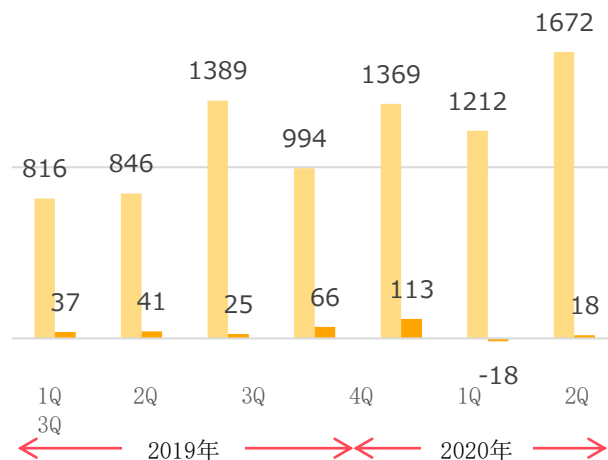
## 硅片再生事业



## Prime Wafer事业



## 半导体相关设备部件等



(百万日元)

# 2020年12月期第3季度 各公司动向季度业绩图

- RS通过强化销售能力等措施，半导体相关设备、部件等的销售增加，营业收入、利润均稳步增长。
- 台湾子公司因季节因素与上一季度相比营业收入与利润减少。预计客户需求将持续旺盛，满负荷生产将持续。
- 中国子公司由于工厂搬迁到德州市新工厂的影响，与上季度相比营业收入与利润减少。

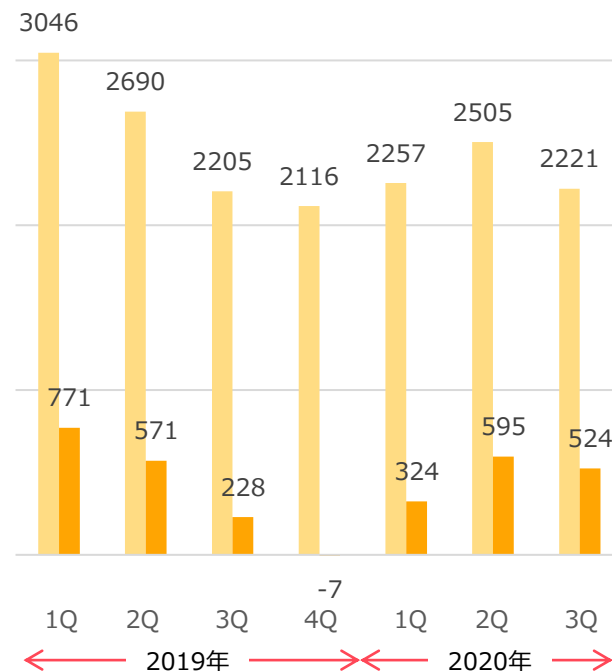
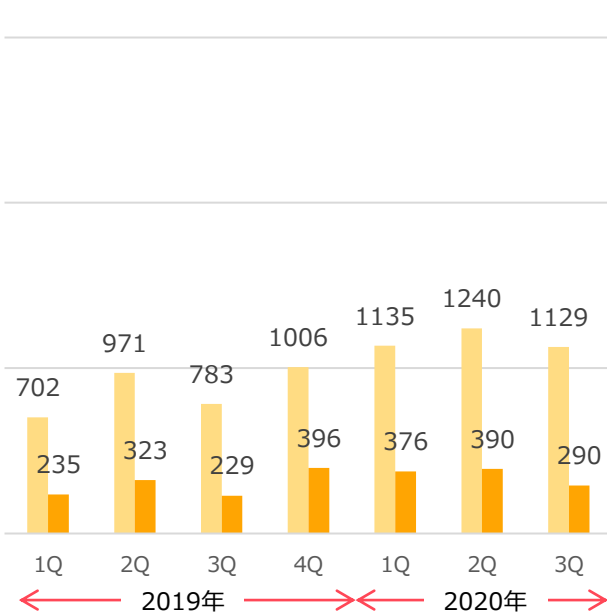
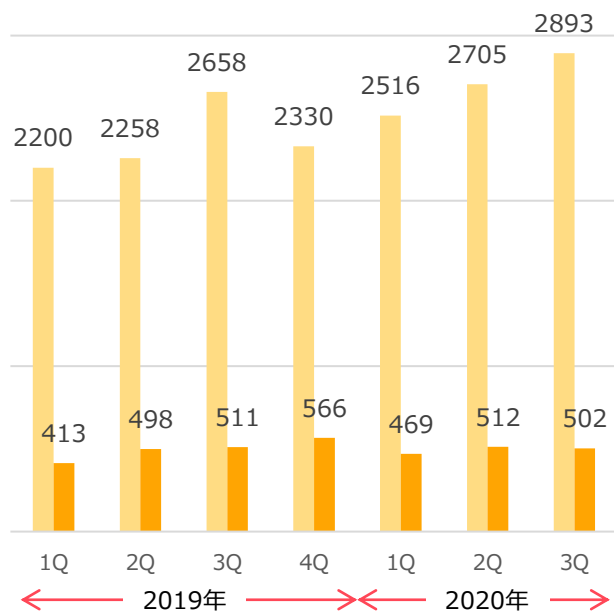
RS

台湾子公司

中国子公司

(百万日元)

■ 売上高  
■ 営業利益





# 资产负债表

- 商品及产品方面，随着半导体相关设备部件等业务的销售增加，与上一季度相比增加了9亿日元。
- 有形固定资产由于对德州新工厂的投资，比上季度增加了73亿日元。

## 合并资产负债表

(百万日元)	2019年12月期	2020年12月期 第3季度
<b>资产部分</b>		
流动资产	32,760	32,776
货币资金	22,156	19,938
应收票据及应收账款	6,047	5,972
商品及产品	1,713	2,684
固定资产	15,873	23,963
有形固定资产	14,635	21,940
無形固定资产	732	580
投资及其他资产	506	1,442
<b>资产总计</b>	<b>48,634</b>	<b>56,740</b>
<b>负债部分</b>		
流动负债	7,252	11,503
应付票据及应付账款	1,614	2,118
有息负债	1,730	1,480
固定负债	5,400	6,110
长期借款	2,232	1,338
<b>负债总计</b>	<b>12,652</b>	<b>17,616</b>
净资产	35,981	39,126
<b>负债与净资产总计</b>	<b>48,634</b>	<b>56,740</b>

### 3. 中期経営計画展望

---

# 中期经营计划（4年）概要

- 硅片再生事业，除了追加日本・台湾工厂之外，还通过中国据点的新设投资来应对需求的扩大。
- Prime Wafer事业方面，8英寸Prime Wafer新工厂将于2020年10月举行竣工仪式并开始运作。同时正在进行12英寸Prime Wafer量产化的研究开发。
- 2023年的目标是营业收入316亿日元，营业利润68亿日元，当期纯利润40亿日元。

	2019年 12月期	2020年 12月期	2021年 12月期	2022年 12月期	2023年 12月期
	实际	修正后计划※	计划※※	计划※※	计划※※
营业收入	24,501	23,500	27,000	29,800	31,600
营业利润	4,717	4,300	4,800	6,100	6,800
营业利润率	19.3%	18.3%	17.8%	20.5%	21.5%
经常利润	5,416	4,800	5,000	6,400	6,900
经常利润率	22.1%	20.4%	18.5%	21.5%	21.8%
归属于母公司股东的净利润	3,035	2,800	3,000	3,600	4,000
每股当期净利润	236.98	216.74	233.84	280.61	311.79

※2020年12月期的修正后计划是2020年7月29日公布的数值

※2021年12月期以后的计划是2020年2月13日公布的数值。

# 设备投资计划：硅片再生事业

■ 在世界半导体需求不断扩大的情况下，除了对日本、台湾进行设备投资外，我们还在中国进行了生产基地新设投资。

## 日本

总投资额： 14亿日元

- 扩充12英寸硅片再生产能
- 2020~2022年：14亿日元(3万片)

### 12英寸硅片再生产能（月产）

2019年 25万片 → 2021年 27万片 → 2022年 28万片

2020年度	2021年度	2022年度
2亿日元	10亿日元	2亿日元

## 台湾

总投资额： 15亿日元

- 12英寸再生硅片的产能扩充及微细化
- 2020~2022年：15亿日元(2万片)

### 12英寸硅片再生产能（月产）

2019年 15万片 → 2021年 17万片 → 2022年 17万片

2020年度	2021年度	2022年度
2亿日元	13亿日元	—

## 中国

总投资额： 38亿日元

- 投资新建12英寸再生硅片生产基地
- 第1期投资(2020~2022年)：38亿日元(5万片)

### 12英寸硅片再生产能（月产）

2019年 0万片 → 2021年 0万片 → 2022年 5万片

2020年度	2021年度	2022年度
5亿日元	—	33亿日元

第1期投资

# 设备投资计划： Prime Wafer事业

- 除了增加8英寸Prime Wafer产量（50,000片/月）的计划之外，正在进行大规模生产12英寸Prime Wafer的研究和开发。

## 中国

总投资额： 140亿日元

- 8英寸Prime Wafer产能扩充
- 2020年10月竣工、开始运行

### 8英寸Prime Wafer产能（月产）

2020年 → 2021年  
7万片 → 12万片

投資期間 2019年～2020年

2020年度	2021年度	2022年度
140亿日元	未定	未定

## 中国

测试线投资额： 50亿日元

- 12英寸Prime Wafer批量生产的研究开发
- 经过1万片测试线，以30万片的量产为目标

### 12英寸Prime Wafer产能（月产）

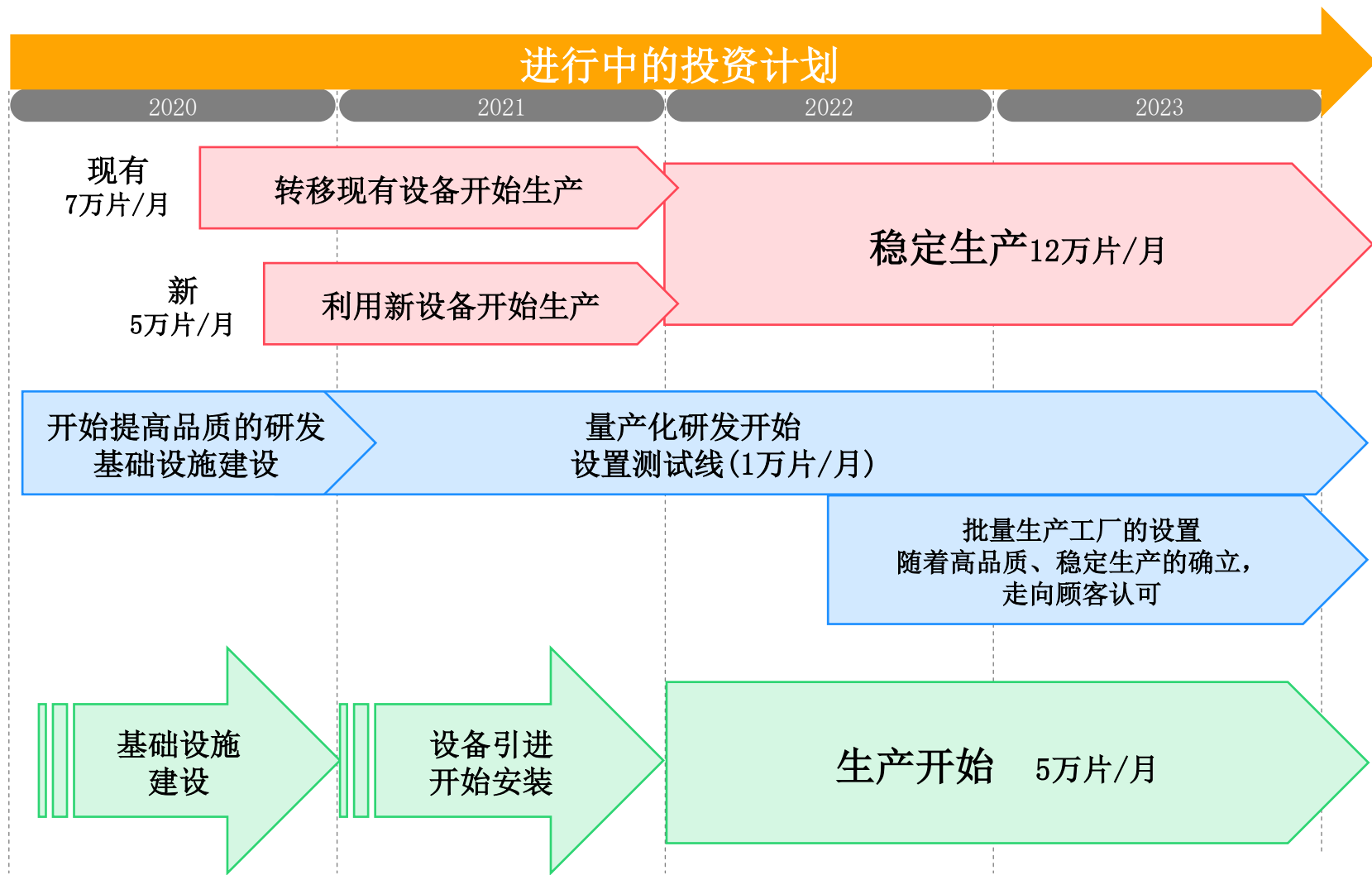
2020年 → 2021年 → 202X年  
0万枚 → 1万片※ → 30万片

2020年度	2021年度	2022年度
5亿日元	45亿日元	未定

※为了量产化研究开发的测试线

# 中国投资计划（时间表）

- 8英寸增产，12英寸量产化的研究开发，硅片再生事业从今年开始并行实施。以早期达到12英寸以高品质化、稳定生产为目标。



# 中国投资计划（目前进展情况）

- 8英寸Prime Wafer新工厂将于10月16日竣工。从北京工厂搬迁过来的现有设备和新引进的设备同时开始运行，正在进行客户认证。
- 为了12英寸Prime Wafer的量产化的研究开发，我们将继续提高单晶棒的质量。

8英寸Prime Wafer的进展情况  
(2020年10月16日 竣工)



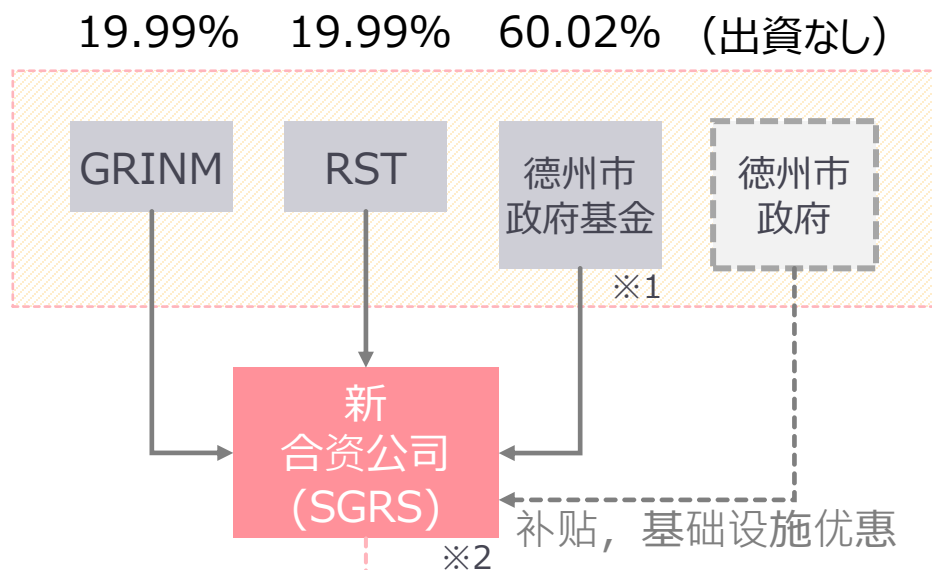
12英寸Prime Wafer的进展情况  
(2020年5月29日摄影 12英寸单晶棒)



# 中国12英寸硅片事业方案

- 与德州市政府等于2020年3月共同成立了一家新合资公司。
- 即使进入12英寸硅片事业，也可以通过降低初始投资比率来抑制初始风险。
- 通过1万片/月的测试线，以30万张/月的量产为目标。

## 合资公司的出资方案



## 合资合同

- 合资合同由四方签订。
- 出资3方 (GRINM、RST、德州政府基金)
- 德州市政府提供基础设施等支持。

## 事业内容

- 12英寸Prime Wafer事业(生产、销售、研发)
- 12英寸硅片再生事业

※1 德州汇达半导体股权投资基金合伙企业 (有限合伙)

※2 山东有研艾斯半导体材料有限公司



# 硅片再生事业的新需求：12英寸半导体新工厂

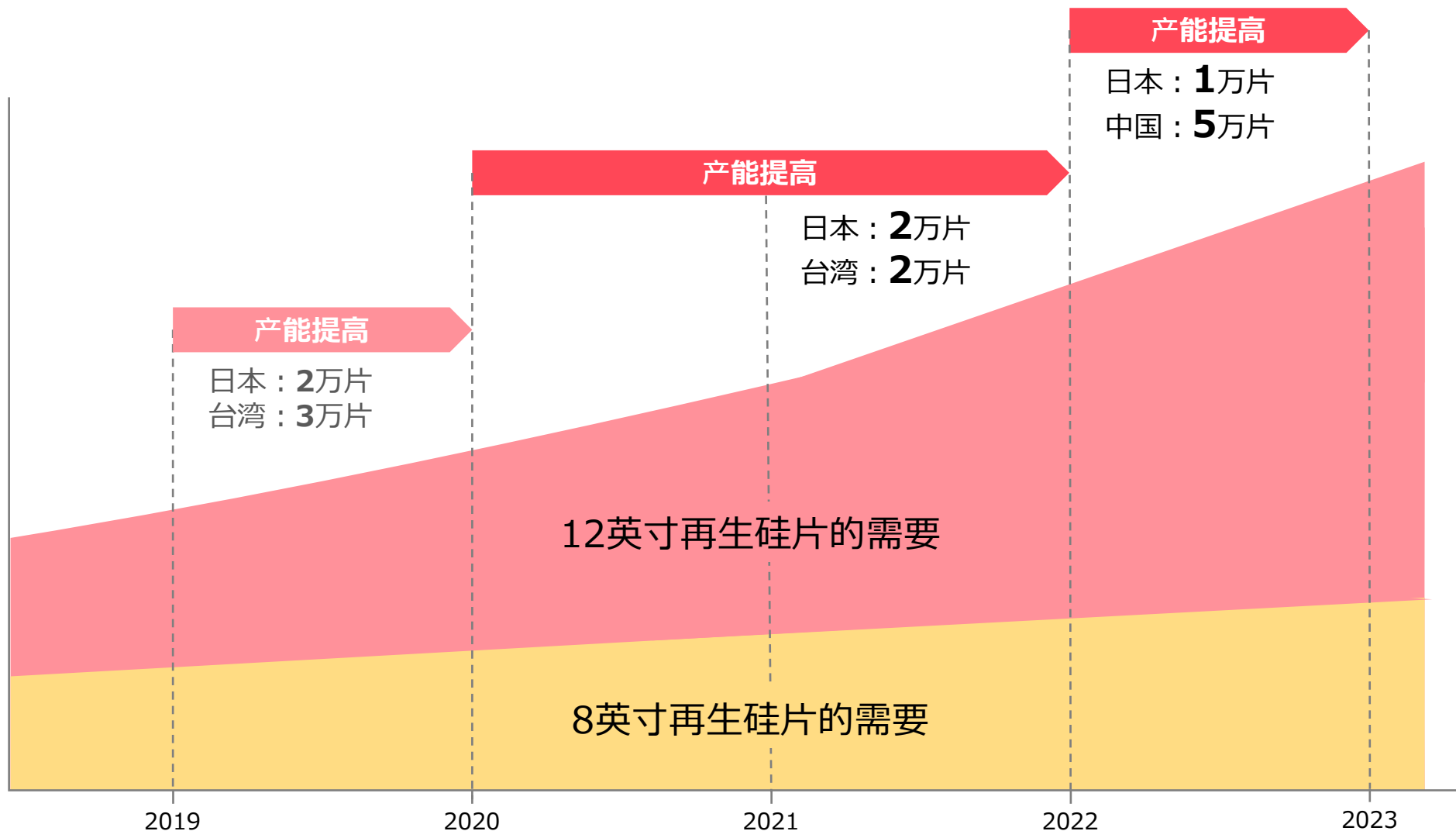
- 为了满足中、欧、日等国家因存储器、CPU、汽车电子化等而产生对半导体强劲的需求，12英寸半导体新工厂正在建设中。
- 通过对日本、台湾及中国的设备投资，应对新的再生硅片需求。



注：RST調べ

# 再生硅片的需求前景：以12英寸为中心持续扩大

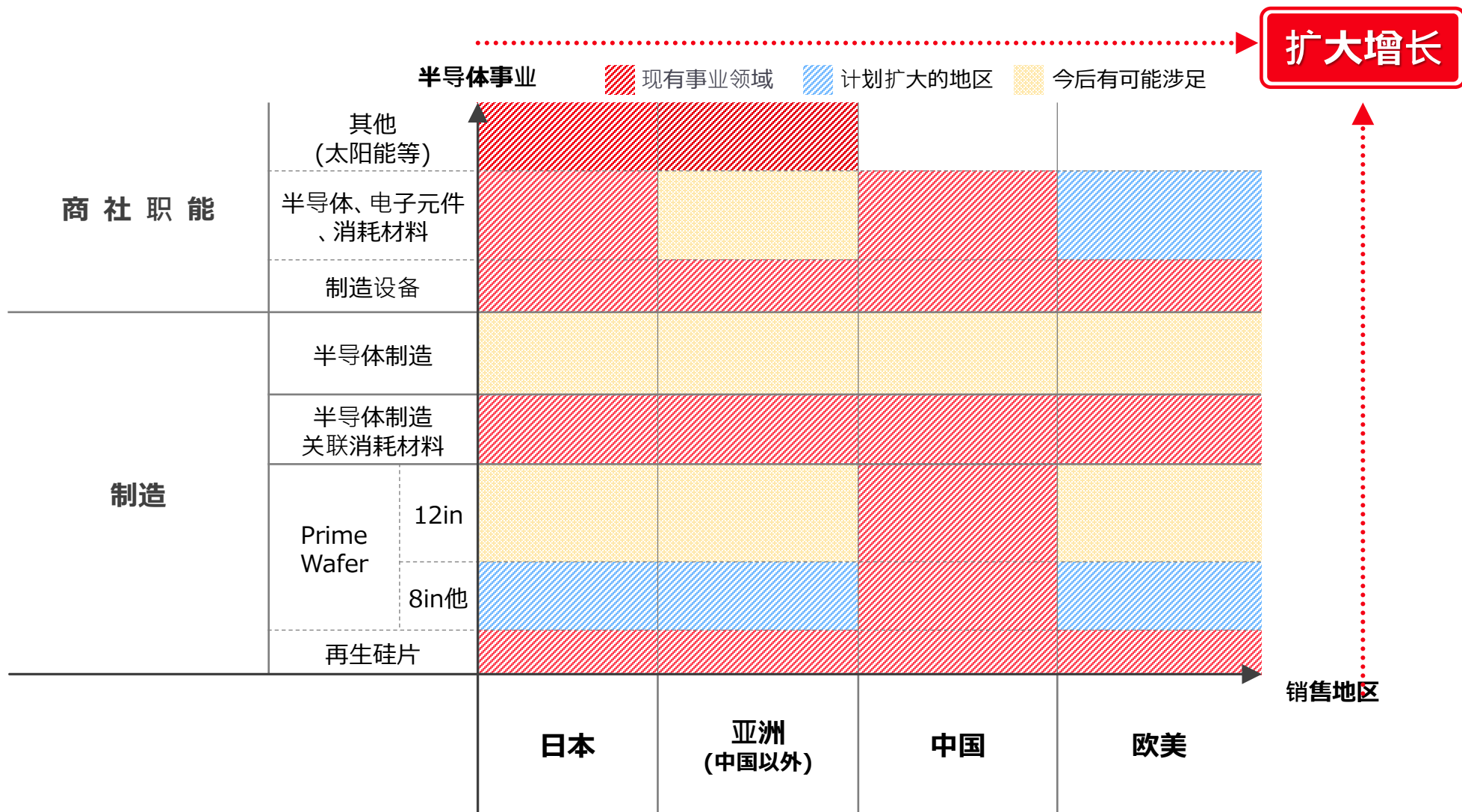
- 为满足不断扩大的再生硅片需求，预计2020 ~ 2022年在日本、台湾、中国分别实现3万片、2万片、5万片的产能提高。



注：RST调查

# RS Technologies追求的世界

■ 一步一步，逐步扩大事业领域和销售地区。



# Appendix

---

# 董事长 方永义的优势

- 董事长总经理方永义的优势是充分发挥20多年来在日本积累的见识和自己拥有的人脉，面向全球的营销能力、人际关系、合作能力及资金实力。
- 方永义麾下集结了高科技、金融等广泛领域的专业人财。



前排中央为方永义（2016年9月摄于东京证券交易所）

方 永义

1970年出生 中国福建省人

城西国际大学研究生院 结业

擅长领域：

并购、业务合作（过去成功并购了超过10家企业）

1998年 成立永辉商事

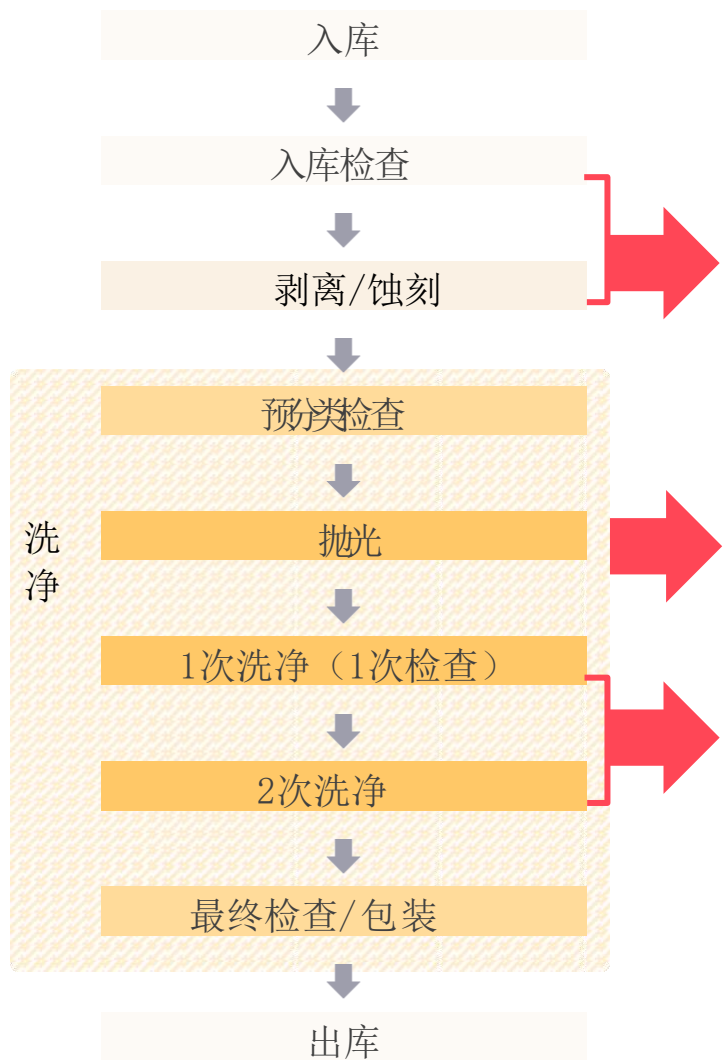
2010年 成立本公司并就任总经理（  
现任）

座右铭：事在人为

补充：

高中毕业后来日。拥有日本国内外的20多家公司的投资经验。除半导体业务外，还有基金、贸易、酒店、IT业务、农业等各种行业的投资经验。以“日本的制造服务世界第一”为信条，奔走于世界各地，向全球推广日本的制造服务。

# 再生硅片业务(1)



## 强项 1

所有膜均可剥离

因通过化学方式进行剥离, 对表面的损伤最小

▶ 再生次数多

▶ 可降低成本

继承了拉萨工业（化学）的特技



傷 凹み



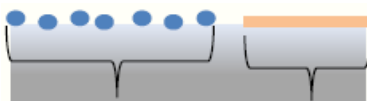
通过抛光去除表面杂质使其平滑

## 强项 2

除去金属不纯物

通过洗净除去硅片表面的细微杂质

+ 除去金属不纯物, 尤其擅长铜 (Cu) 的除色除杂质



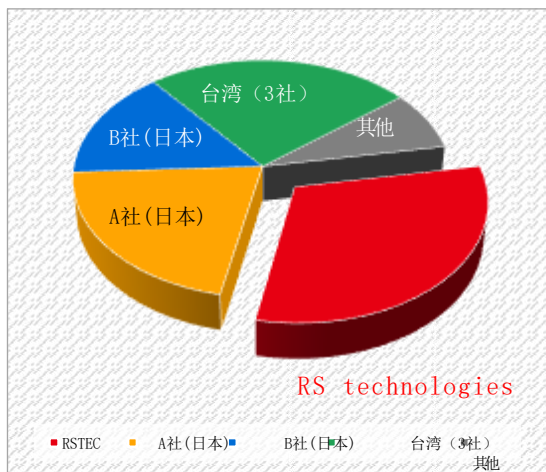
杂质 (粒子) 金属不纯物



# 再生硅片业务(2)

## 扩大本公司在再生市场占有的份额

本公司在12英寸硅片市场上所占的份额



注：RST调查

由于增设了台湾工厂和三本木工厂，生产能力提高了，目前的市场份额已上升到约33%。

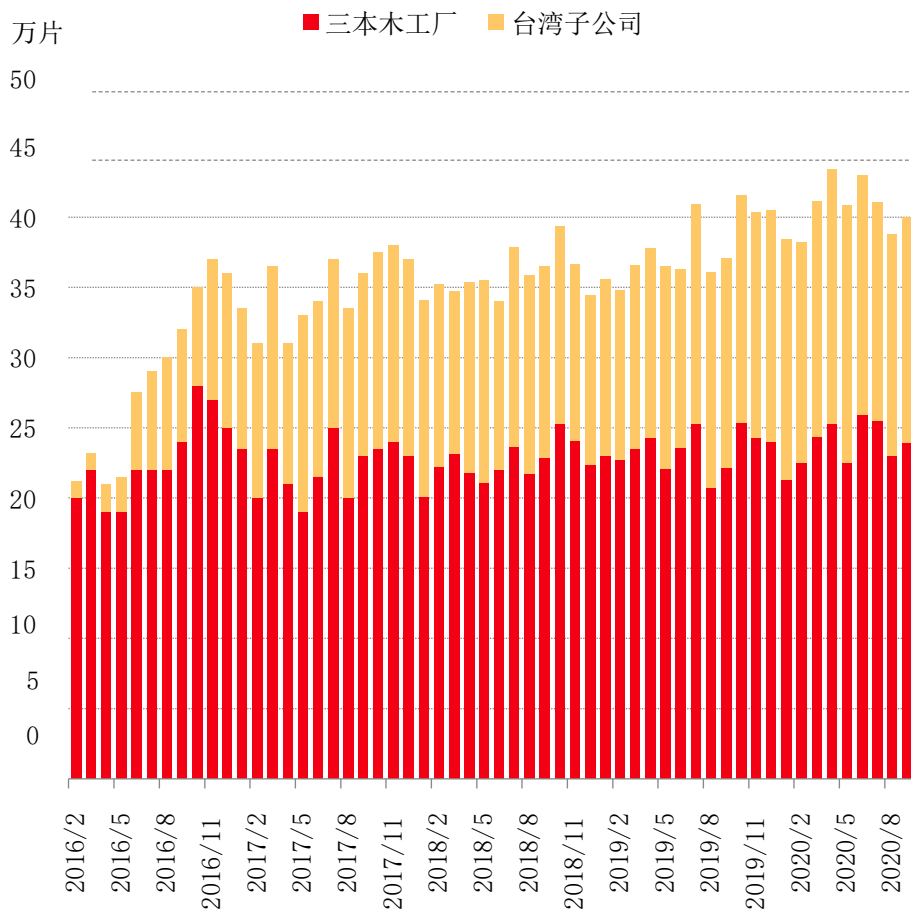
旨在通过利用两家工厂的现有设施提高生产力，利用三本木的空工厂，业务合作和并购等方式进一步扩大市场占有率。

	2015年 上半年	2015年 下半年	2016年	2017年	2018年	2019年
本集团生产能力	18万片	24万片	28万片	30万片	34万片	40万片
本集团所占 市场份额	19%	24%	29%	30%	31%	33%

注：RST调查

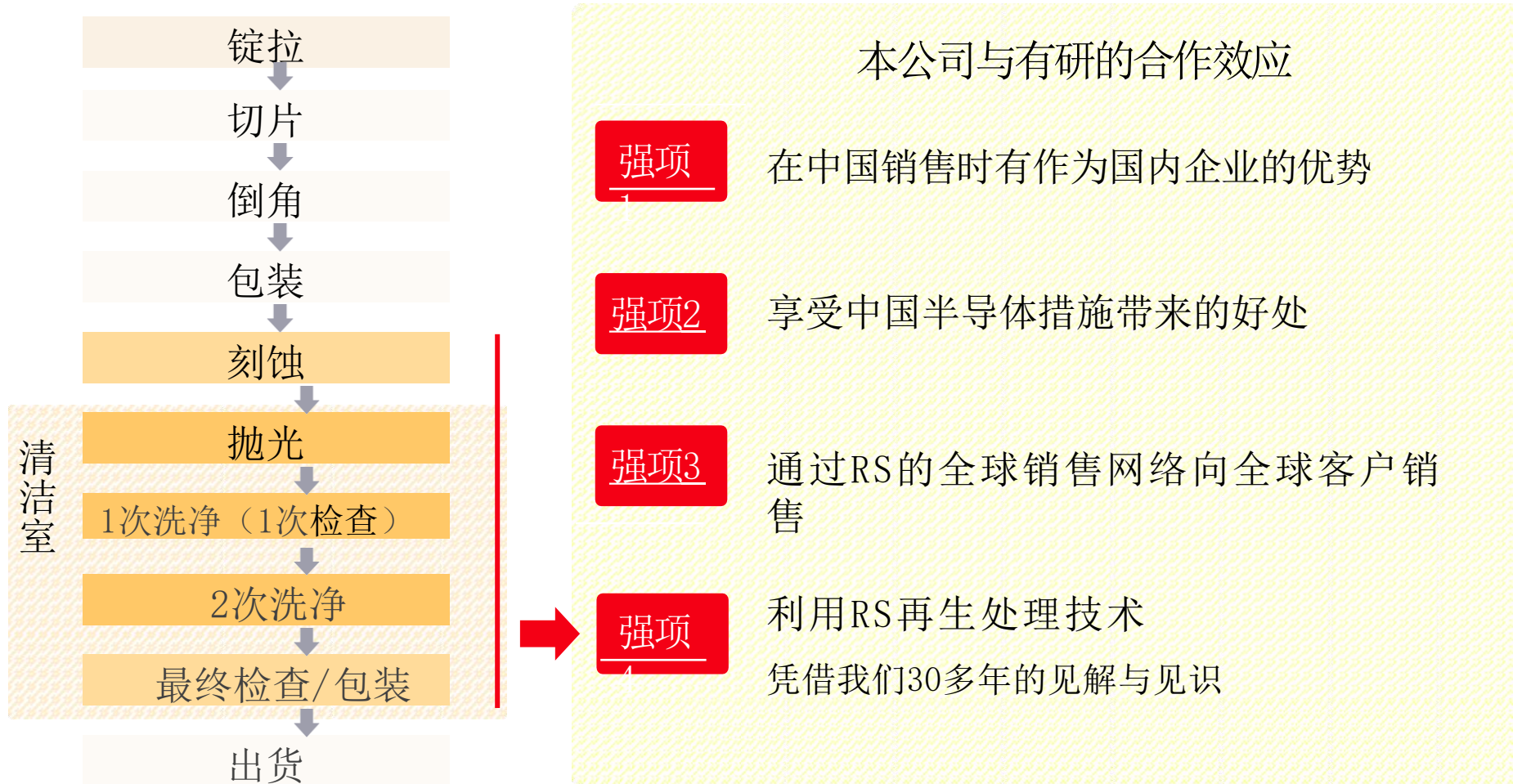
## 三本木工厂和台湾子公司的出货量 (2016年-2020年)

三本木工厂和台湾子公司的12英寸硅片出货量



# 进军Prime Wafer行业

与中央政府直属企业北京有色金属研究总院（现为有研科技集团有限公司）成立合资公司。作为国内公司（中国国内公司）发展半导体业务





# 关于我们在中国的合资伙伴

- 成立于1952年。中国有色金属领域最大的国有研究所。
- 在中国大约1300万家公司中，国有企业有30万家。其中，中央政府直属企业有88家，GRINM是其中之一。
- 这是一个集政府，产业和学术界于一体的研究机构，中央政府在有色金属领域的政策是通过该公司宣布的。
- 为发扬研究成果，成立事业公司。目前，有34家公司。
- 本公司的合资子公司GRITEK是在北京有研艾斯半导体科技有限公司（BGRS）伞下成立于2001年的第一家事业公司。



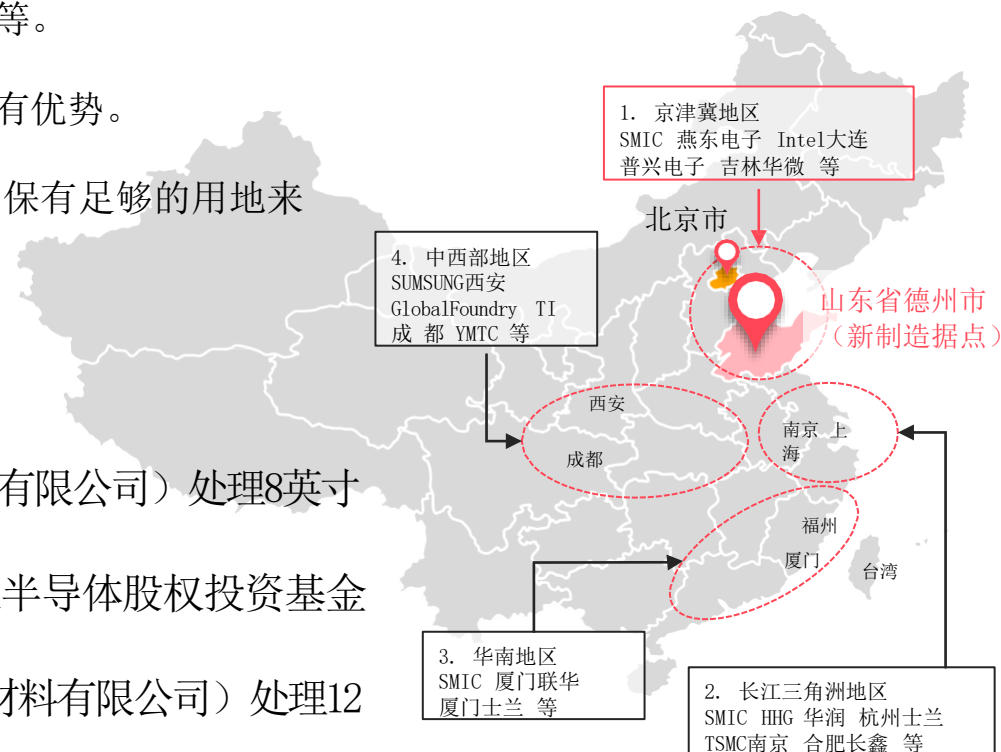
# 与德州市的合作：背景、经过及现状（山东有研新工厂竣工）

## 合作背景

1. 世界主要半导体制造商被吸引到周边地区建工厂，是靠近半导体制造商聚集地的良好位置（参见右图）
2. 福利待遇优厚，例如减免水电费及提供廉价的公司宿舍等。
3. 附近有一所理工系大学，在获得优秀的人力资源方面具有优势。
4. 该基地最大可扩展至约50万m<sup>2</sup>（最初为20万m<sup>2</sup>），可确保有足够的用地来应对未来在中国的业务推进。

## 经过和现状

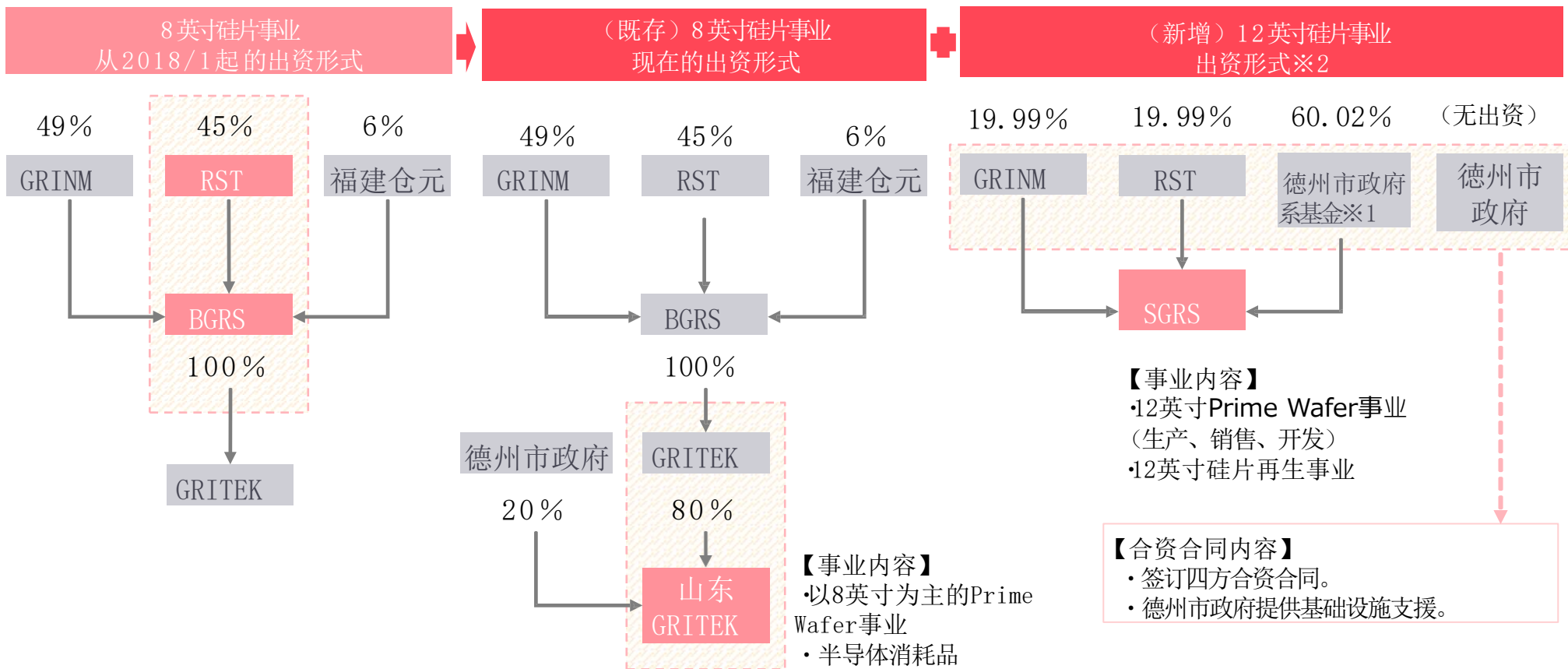
1. 2018年8月23日成立新公司（山东有研半导体材料有限公司）处理8英寸硅片业务。
2. 2019年12月与有研科技集团有限公司、德州汇达半导体股权投资基金合伙企业及山东省德州市政府签订四方合资合同。
3. 2020年3月成立新合资公司（山东有研艾斯半导体材料有限公司）处理12英寸硅片业务。
4. 2020年10月16举行德州市新工厂竣工仪式。



# 对中国事业的出资

■ 与GRINM，德州市政府等共同成立新的合资公司（山东有研艾斯半导体材料有限公司：SGRS），开展12英寸硅片业务。通过降低初始投资比率，控制初期风险。

■ 在新合资公司从事的12英寸硅片业务中，我们的目标是通过1万片/月的试生产线实现3万片/月的量产体制。另外，硅片再生事业第一阶段作为投资的目标是每月生产5万片。



※ 1德州汇达半导体股权投资基金合伙企业（有限合伙）

※ 2详情请参阅2019年12月18日公示的资料《关于中国投资计划部分变动的通知》。

出资比例为最终出资比例，根据出资协议执行。

# 业绩变化

(百万日元)	2013年12月期	2014年12月期	2015年12月期	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期
营业收入	3,475	4,566	5,285	8,864	10,932	25,478	24,501
毛利润	1,173	1,820	1,852	2,544	4,252	8,366	7,940
营业费用	471	654	791	958	1,269	2,615	3,223
营业利润	703	1,166	1,061	1,585	2,982	5,751	4,717
经常利润	819	1,247	770	1,444	3,159	6,141	5,416
当期净利润 ※	525	664	143	861	2,113	3,620	3,035
分红 (日元)	—	—	—	10	5	10	15
设备投资	338	3,503	4,665	209	95	1,328	4,809
折旧	87	103	326	682	714	1,298	1,814
研究开发费	1	6	11	85	183	501	449
员工人数 (正式员工) (人数)	152	191	265	373	434	1,159	1,277

※親会社株主に帰属する当期純利益

# 主要财务报表

(百万日元)	2013年12月期	2014年12月期	2015年12月期	2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期
<b>资产部分</b>							
流动资产	1,811	2,759	3,732	5,348	7,388	26,074	32,760
货币资金	397	1,190	1,842	1,952	3,243	14,879	22,156
应收票据及应收账款	681	696	795	2,531	2,916	6,958	6,047
商品及产品	396	376	361	348	446	1,343	1,713
固定资产	508	4,064	5,845	5,333	4,843	10,516	15,873
有形固定资产	461	3,918	5,667	5,152	4,674	8,963	14,635
无形固定资产	19	15	29	23	19	1,099	732
投资及其他资产	27	130	148	158	149	453	506
<b>资产合计</b>	<b>2,320</b>	<b>6,823</b>	<b>9,577</b>	<b>10,682</b>	<b>12,231</b>	<b>36,591</b>	<b>48,634</b>
<b>负债部分</b>							
流动负债	960	2,292	2,295	2,993	3,370	4,979	7,252
应付票据及应付账款	138	151	186	283	398	1,554	1,614
有息负债	136	827	1,216	1,538	1,276	976	1,730
固定负债	709	2,934	4,798	4,317	3,335	2,474	5,400
长期借款	615	2,925	4,079	3,620	2,767	1,848	2,232
<b>负债合计</b>	<b>1,670</b>	<b>5,227</b>	<b>7,093</b>	<b>7,310</b>	<b>6,705</b>	<b>7,453</b>	<b>12,652</b>
<b>净资产部分</b>							
净资产	649	1,596	2,483	3,371	5,526	29,137	35,981
<b>负债与净资产合计</b>	<b>2,320</b>	<b>6,823</b>	<b>9,577</b>	<b>10,682</b>	<b>12,231</b>	<b>36,591</b>	<b>48,634</b>

2013年12月期是单独决算。

# 各事业业绩变化

(百万日元)	2013年 12月期	2014年 12月期	2015年 12月期	2016年 12月期	2017年 12月期	2018年 12月期	2019年 12月期
营业收入							
硅片再生事业	3,347	4,414	5,107	7,144	9,487	10,973	10,776
Prime Wafer制造销售事业	—	—	—	—	—	11,918	10,058
半导体相关装置部件等事业	—	—	—	1,654	1,393	2,918	4,047
其他, 调整金额	127	151	178	66	52	△331	△380
各事业利润							
硅片再生事业	916	1,444	1,377	1,765	3,396	4,011	4,081
Prime Wafer制造销售事业	—	—	—	—	—	2,048	1,503
半导体相关装置部件等事业	—	—	—	230	130	366	171
其他, 调整金额	△214	△278	△316	△409	△543	△675	△1,038
各事业资产							
硅片再生事业	1,337	5,040	6,987	5,657	8,120	9,150	10,336
Prime Wafer制造销售事业	—	—	—	—	—	21,313	29,311
半导体相关装置部件等事业	—	—	—	1,137	1,305	1,939	3,179
其他, 调整金额	982	1,783	2,589	3,887	2,805	4,315	5,806

2015年、2016年、2017年12月期的决算数值是2019年3月5日公布的修正后的数值。

本资料中记载的内容，是在一般认为的经济形势和本公司认为合理的一定前提下制作的，若因外部经营环境的变化而更改，恕不提前通知。

在本次发布时获得的资料和信息当中，包括“预测信息”。这些信息是根据现在的估计、预测以及带有风险的假设得出的，含有不确定性，也许与实际结果相左。

即使今后出现新的信息、事情等，本公司也不承担更新和修正本次发布所含的“预测信息”的义务。